长波长大应变 InGaAs/InGaAsP 分布反馈激光 器的材料生长与器件制备 *

潘教青*赵 谦 朱洪亮 赵玲娟 丁 颖 王宝军 周 帆 王鲁峰 王 圩

(中国科学院半导体研究所光电子研究发展中心,北京 100083) (2005年9月12日收到,2005年10月31日收到修改稿)

采用低压金属有机化合物气相沉积法 LP-MOCVD)生长并制作了 1.6—1.7 μ m 大应变 InGaAs/InGaAsP 分布反馈 激光器.采用应变缓冲层技术 ,得到质量良好的大应变 InGaAs/InP 体材料.器件采用了 4 个大应变的量子阱 ,加入了 载流子阻挡层改善器件的温度特性.1.66 μ m 和 1.74 μ m 未镀膜的 3 μ m 脊型波导器件阈值电流低(小于 15mA),输出 功率高(100mA 时大于 14mW).从 10—40℃ ,1.74 μ m 激光器的特征温度 $T_0 = 57$ K ,和 1.55 μ m InGaAsP 分布反馈激光器的特征温度相当.

关键词:MOCVD, InGaAs/InGaAsP, 应变量子阱, 分布反馈激光器 PACC: 4255P, 7280E

1.引 言

气体分子光吸收谱就像人类的指纹,它是气体 种类识别和气体分子浓度测定的有效手段^[1],例如 1.3μm 用于探测水汽^[12],1.66μm 用于探测甲烷, 1.74μm 探测氯化氢^[3],2.0μm 探测水汽、溴化氢、二 氧化碳和 NO_x.光谱气体传感是利用波长范围在 1—20μm的不同气体的分子振动/转动吸收特征谱来 检测气体种类和浓度的方法.激光光源早期一般采 用固定频率的气体激光器或可调谐铅盐激光器,采 用和气体吸收谱线刚好重合的激光波长,但是重合 的位置不一定是气体吸收最强的谱线.有关可调谐 铅盐激光器用于微量气体传感的研究开展的较早, 可获得良好的气体选择性和很高的检测灵敏度.然 而这种激光器价格昂贵,发射谱线多模,输出功率相 对较低,结构笨重,而且需要工作于低温环境.这些 因素严重制约了其在气体传感中的广泛应用.

另一方面,光纤通信的迅猛发展使相对低价、工作于常温、波长可调谐的高质量近红外发光二极管 (例如 0.8,1.3,1.55μm 的激光二极管)获得广泛的 应用.特别是 InGaAsP/InP 材料体系的器件,无论在 器件的制作工艺上还是器件的可靠性方面都有较成 熟的研究和实用成果.研究发现,这些近红外发光二 极管的发射波长与很多环境及工业气体的复合吸收 谱线相一致.鉴于此,可以用近红外发光二极管作为 气体传感系统的光源,而且近红外半导体激光二极 管可以做到单模输出,功率也可达数毫瓦,室温工 作,并且可以借助于随光纤通信发展而已较成熟的 光纤光学技术及廉价的辅助设备,如低噪声的电流 驱动器、聚光镜、探测器及光学隔离器等.随着光通 讯的发展而不断成熟的的近红外激光二极管技术用 于气体传感,将在工农业生产、有毒气体监测、医药分 析、健康、安全等诸多领域具有非常广泛的应用前景.

气体的吸收谱线线宽一般在几百至几千兆赫兹 红外灯和发光二极管的线宽远大于气体分子的吸收线宽 应用于气体传感难度很大.半导体分布反馈激光器由于在有源区制备有光栅,能够输出稳定的单模激光,线宽在百兆赫兹以下,很适合气体传感应用.通过调节激光器的工作电流和温度可以调谐激光器的波长,使它精确地稳定在气体的吸收谱线上.近年来气体传感的研究工作取得了很多进展^[4-7]相关应用也有很多商用产品问世.激光器的 工作温度的稳定是通过半导体制冷器实现的,在移

^{*}国家自然科学基金(批准号 160176023)资助的课题.

[†] E-mail: jqpan@red.semi.ac.cn

动式气体探测器中要求激光器和制冷器的功耗尽量 小,这样可以缩小电源的体积和重量,或者在电源的 体积和重量不变的情况下,延长探测器的工作时间. 因此制备低阈值电流密度和高效率的分布反馈激光 器很有意义。

然而随着波长的增加,要求 InGaAs/InGaAsP 量 子阱中阱的带隙不断减小、In 组分不断增加,应变 也在不断地增加,对于带隙较小的材料,低生长温度 是有利的,因此很多1.7-2.0µm InGaAs/InGaAsP激 光器是用 MOMBE 或 MBE 生长的^[8-10].而使用 MOCVD 制备 1.7µm InGaAs/InGaAsP 激光器报道 较少[12]

本文主要针对甲烷、氯化氢等气体探测的需要 使用 MOCVD 制备了波长为 1.66, 1.74 µm 的分布反 馈激光器,下面从材料生长、器件制备、性能测试分 别进行描述。

2. 大应变 InGaAs 材料的 MOCVD 生长

对于 InGaAsP/InP 材料体系来说,与 InP 晶格匹 配的材料其发光波长为 1.1—1.65µm ,加入应变超 晶格结构,该材料体系的发射波长可达 2.0µm;在发 光器件中引入适当的应力,有望进一步降低阈值电 流密度 通过一定的外延层设计 减少非辐射复合, 从而提高长波段的发光效率,但应变超晶格结构的 生长具有一定的难度,有时含有应变超晶格的激光 二极管易于退化.这增加了制作 1.6-2.0µm DFB 半 导体激光器的难度,大应变的 InGaAs 在生长时容易 发生晶格驰豫 产生铟凝析的现象 形成富铟的'小 岛". 铟凝析主要和以下两点有关, 一是生长条件, 二 是生长表面的质量,生长条件已经研究的比较充分 了 例如低生长温度 ,高生长速度 ,高 Ⅴ / Ⅲ 经常应 用在大应变材料生长中,应力层可以消除线缺 陷^{11]}因此在生长大应变材料之前生长一应力较 小、厚度远小于临界厚度的应力缓冲层来消除大部 分的线缺陷 在这个基础上生长大应变的材料比较 有利.

材料生长用的设备是 AIXTRON 200 型低压金 属有机化合物气相沉积设备(LP-MOCVD),卧式反 应炉,载有衬底片的托盘旋转速度为 60r/min,生长 温度是 655℃,生长压力为 2.2 × 10³ Pa. Ⅲ族源分别 是 :三甲基镓(TMGa),三已基镓(TEGa),三甲基铟 (TMIn). V 族源分别是:砷烷(AsH,),磷烷(PH,).

n型掺杂源和 p型掺杂源分别是:硅烷(SiH,),二已 基锌(DEZn). 生长 InGaAs 时 V/Ⅲ为 70, 生长 In-GaAsP时V/Ⅲ为250.

首先采用应变缓冲层技术生长大应变的 InGaAs 体材料.如图1所示 在 InP 缓冲层上生长一个 6nm 的应变量为 0.9%的 In_{0.66} Ga_{0.34} As 应变缓冲层,然后 是 40nm 的 InP 层 ,40nm 的大应变 In_{0.81} Ga_{0.19} As 层, 最后是 10nm 的 InP 盖层.该结构生长完成以后用双 晶 X 射线衍射仪进行测试,得到的结果如图 2 所 示.图中显示 InGaAs 体材料的应变为 1.9% 衍射峰 清楚,而且出现了规则的Pendellosung调制条纹.说 明 InGaAs 体材料没有晶格驰豫,是共格生长的.没 有采用应变缓冲层技术生长的大应变的 InGaAs 体 材料没有规则的 Pendellosung 调制条纹 ,而且大应变 InGaAs 衍射峰的半峰宽明显变宽(在图 2 中没有显 示).这说明 6nm 的应变量为 0.9% 的 In_{0.66} Ga_{0.34} As 应变缓冲层能够改善 InP 表面的质量,在这个表面 上生长大应变材料是可行的.





应用应变缓冲层生长大应变材料时的结构示意图

图 2 应变量为 1.9% 样品的 X 射线摇摆曲线

3. 器件结构与制备

较小阱宽的量子阱微分效率高 阈值电流低 大

的压应变能够降低俄歇复合、带间吸收 提高输出功 率.和 InP 衬底晶格匹配的 Ino 53 Gao 47 As 的发光波长 在 1.65µm ,为了提高 1.66µm 激光器的性能 ,我们采 用了应变量为 1.2%的 In_{0.67} Ga_{0.33} As 作为阱材料,阱 宽为 6nm , 全的宽度为 12nm. 发光波长为 1.74μm 的 激光器采用了应变量为 1.6% 的 In_{0.76} Ga_{0.24} As, 阱宽 为 6.5nm , 垒的宽度为 12nm. 器件结构如图 3 所示. 首先在 n 型 InP 衬底上生长 1µm 的 Si 掺杂的 InP 缓 冲层,然后是夹在上下分别限制层(SCH)中的4对 量子阱,在下限制层中有 6nm 的应变量为 0.9% 的 Ing Gag a As 应变缓冲层.该缓冲层和量子阱之间的 距离为 40nm, 起到的作用和图 1 中的类似. 通常激 光器的载流子和光子是被分别限制异质结(Separate Confinement Heterostructure SCH)分别限制的,光限制 层带隙较小 对光场的限制较好 但是对载流子的限 制较弱.这样载流子容易从量子阱中泄露出来,这是 特征温度低的一个主要原因.通常 SCH 包含两个能 带台阶 JnP 包层和波导层(如 1.10,1.20)之间的台 阶形成光波导 波导层和有源层之间的台阶形成对 载流子的限制,但是这个台阶对载流子的限制比较 弱,为了减少载流子从量子阱中的泄露,一种有效的 办法是加入一个带隙较大的载流子阻挡层(Carrier Blocking Layer),能够提高器件的特征温度^[12,13],图 3 的器件结构中也有载流子阻挡层 起到增强限制载 流子的作用.根据不同波长的要求应用激光全息的 方法制备周期不同的光栅图形 ,先干法刻蚀后湿法 腐蚀得到光栅结构,然后二次外延生长 InP 层和 p 型的 InGaAs 接触层.制备条宽为 3µm 的脊波导结构 激光器 制备 p 型电极 TiPrAu ,背减薄后制备 n 型电 极 AuGeNi.未镀膜的激光器 p 面向上放在铜热沉上 进行测试.



4. 器件测试与分析

图 4 是波长为 1.669µm 的激光器的波谱和光功 率-电流曲线,该激光器的波长对应甲烷吸收谱线. 边模抑制比(SMSR)为 36dB;阈值电流为 15mA(室温 25℃),最大输出功率大于 14mW(100mA),且没有饱 和迹象.图 5 是波长为 1.74µm 的激光器的波谱和光 功率-电流曲线,该激光器的波长对应 HCl 气体吸收 谱线.边模抑制比(SMSR)为 33.5dB;阈值电流为 11mA(20℃),最大输出功率大于 14mW(100mA),且 没有饱和迹象.

激光器的特征温度高,则激光器的温度稳定性 好.如前所述,激光器在气体探测应用中采用固定工 作电流,通过调节工作温度使激射波长精确地稳定 在气体的吸收谱线上.对于长波长激光器俄歇复合 速率随温度及带隙 *E*g 的变化是指数关系,因此对 于本文中的 InGaAs 这种窄带隙材料,俄歇复合速率 显著提高,这是造成长波长激光器特征温度低的另 一个主要原因.如第3部分所述,我们采用了大压应 变的量子阱,加入载流子阻挡层,并测试了 1.74µm 激光器的温度特性,即通过激光器管芯一侧的半导 体制冷器和热敏电阻分别设定激光器的工作温度分



图 4 1.66µm 波长的 DFB 激光器的波谱图和光功率-电流曲线

别为 10,20,30,和 40℃,分别测试了激光器的光输 出功率-电流曲线.图 5显示了随温度的升高,光输 出功率不断下降.其中插入图给出了阈值电流随温 度的变化关系,由 $I_{th} = I_0 \exp(T/T_0)$ 得到该激光器 的特征温度 $T_0 = 57$ K,和我们实验室制备的 1.55 μ m InGaAsP 分布反馈激光器的特征温度相当.说明该激光器的结构设计改善了长波长 InGaAs 激光器的温度特性.



图 5 1.74µm 波长的 DFB 激光器的波谱图和光功率-电流曲线

5.结 论

MOCVD 生长并制备了 1.6—1.7μm 大应变 InGaAs/InGaAsP分布反馈激光器,采用应变缓冲层技 术可以明显改变晶体生长质量.制备了 3μm 脊型波 导结构半导体激光器,阈值电流低(小于 15mA),效 率高(100mA时大于 14mW,且没有饱和迹象),满足 气体探测的需求.通过一定的器件结构设计, 1.74μm分布反馈激光器的特征温度为 57K,和 1.55μm通讯用 InGaAsP/InP激光器的相当.

- [1] Proceedings of the 4th summer school on quantum electronics, "Laser and Their Application", Sept 29 to Oct 4 1986 Sunny Beach, Bulgaria.
- [2] Cassidy D T 1988 Appl. Opt. 27 610
- [3] Ubukata A, Dong J, Masusaki H, Satoh T, Matsumoto K 1998 Jpn. J. Appl. Phys. 37 2521
- [4] Edwards C S , Barwood G P , Gill P , Schirmer B , Venzke H , Melling A 1999 Appl. Opt. 38 4699
- [5] Teichert H, Fernholz T, Ebert V 2003 Appl. Opt. 42 2043
- [6] Gurlit W, Zimmermann R, Giesemann C, Fernholz T, Ebert V, Wolfrum J, Platt U, Burrows P 2005 Appl. Opt. 44 91
- [7] Kan R F, Liu W Q, Zhang Y J, Liu J G, Dong F Z, Gao S H, Wang M, Chen J 2005 Acta Phys. Sin. 54 1927 (in Chinese)[阚 瑞峰、刘文清、张玉钧、刘建国、董凤忠、高山虎、王 敏、陈

军 2005 物理学报 54 1927]

- [8] Bai J S , Fang Z J , Zhang Y M , Chen G T , Li A Z , Chen J X 2001 Chinese Journal of Semiconductors 22 126
- [9] Mitsuhara M, Ogasawara M, Oishi M, Sugiura H, Kasaya K 1999 IEEE Photon Technol. Lett. 11 33
- [10] Kuang G K , Böhm G , Grau M , Rösel G , Amann M C 2000 Electron Lett. 36 634
- [11] Schlenker D , Miyamoto T , Chen Z , Koyama F , Iga K 2000 J. Cryst. Growth 209 27
- [12] Ubukata A , Dong J , Matsumoto K 1999 Jpn. J. Appl. Phys. 38 1243
- [13] Hausser S, Meier H P, Germann R, Harder C S 1993 IEEE J. Quantum Electron 29 1596

Material growth and device fabrication of highly strained InGaAs/InGaAsP long wavelength distributed feedback lasers

Pan Jiao-Qing[†] Zhao Qian Zhu Hong-Liang Zhao Ling-Juan Ding Ying

Wang Bao-Jun Zhou Fan Wang Lu-Feng Wang Wei

(Optoelectronic Research and Development Center, Institute of Semiconductor, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China) (Received 12 September 2005; revised manuscript received 31 October 2005)

Abstract

 $1.6-1.7\mu$ m highly strained InGaAs/InGaAsP distributed feedback lasers was grown and fabricated by low pressure mentalorganic chemical vapor deposition. High quality highly strained InGaAs/InP materials were obtained by using strain buffer layer. Four pairs of highly strained quantum wells were used in the devices and carrier blocking layer was used to improve the temperature characteristics of the devices. The uncoated 1.66μ m and 1.74μ m lasers with ridge wave guide 3μ m wide have low threshold current (<15mA) and high output power(>14mW at 100mA). In the temperature range from 10° C to 40° C, the characteristic temperature T_0 of the 1.74μ m laser is 57K, which is comparable to that of the 1.55μ m-wavelength InGaAsP/InP-DFB laser.

Keywords : MOCVD , InGaAs/InGaAsP , strained quantum well , distributed feedback laser PACC : 4255P , 7280E

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60176023)

[†] E-mail: jqpan@red.semi.ac.cn